



2021年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2021年3月26日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <https://www.mimasu.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 細谷 信明
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 2021年4月14日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年5月期第3四半期の業績(2020年6月1日～2021年2月28日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年5月期第3四半期	63,678	△7.5	4,856	1.2	4,813	6.3	3,296	5.8
2020年5月期第3四半期	68,822	△4.2	4,797	6.0	4,528	1.3	3,114	0.2

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年5月期第3四半期	102.61	—
2020年5月期第3四半期	96.95	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年5月期第3四半期	90,229	65,840	73.0
2020年5月期	101,576	63,541	62.6

(参考)自己資本 2021年5月期第3四半期 65,840百万円 2020年5月期 63,541百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年5月期	—	16.00	—	16.00	32.00
2021年5月期	—	16.00	—		
2021年5月期(予想)				17.00	33.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2021年5月期の業績予想(2020年6月1日～2021年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	84,000	△8.8	6,000	1.2	5,900	4.9	4,040	4.3	125.76

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年5月期3Q	35,497,183株	2020年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	2021年5月期3Q	3,372,163株	2020年5月期	3,371,224株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2021年5月期3Q	32,125,523株	2020年5月期3Q	32,126,360株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報)	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況が続きましたが、経済活動が再開される中で、生産や輸出等に持ち直しの動きが見られました。

当社の主要なユーザーである半導体関連各社の設備投資は回復基調で推移したものの、全体の投資動向としては引き続き慎重な姿勢が見られました。一方で、半導体シリコンウエハーの生産は、半導体デバイス需要の増加を受け、コロナ禍の中でも堅調に推移いたしました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は636億7千8百万円と前年同四半期比7.5%の減収となりましたが、営業利益は48億5千6百万円(前年同四半期比1.2%増)、経常利益は48億1千3百万円(同6.3%増)、四半期純利益は32億9千6百万円(同5.8%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、300mmウエハー(再生ウエハーを含む)を中心に生産は堅調に推移いたしました。そうした中で、更なる品質の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、ともに減収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は、有形固定資産の減少等により、前事業年度末と比較して113億4千7百万円減少し、902億2千9百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により136億4千6百万円減少し、243億8千8百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加22億6千8百万円等により、658億4千万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2020年12月24日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年5月31日)	当第3四半期会計期間 (2021年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,333	20,460
受取手形及び売掛金	27,308	24,344
商品及び製品	1,053	283
仕掛品	1,007	840
原材料及び貯蔵品	2,398	2,535
その他	1,029	354
貸倒引当金	△4	△2
流動資産合計	51,126	48,815
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	23,545	22,860
機械及び装置(純額)	16,397	11,684
その他(純額)	7,365	4,148
有形固定資産合計	47,308	38,692
無形固定資産		
投資その他の資産	1,135	1,005
その他	2,007	1,715
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	2,006	1,714
固定資産合計	50,450	41,413
資産合計	101,576	90,229
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	20,284	17,404
短期借入金	100	25
未払法人税等	387	718
引当金	151	566
その他	16,096	4,769
流動負債合計	37,020	23,485
固定負債		
退職給付引当金	849	737
その他	165	165
固定負債合計	1,015	903
負債合計	38,035	24,388

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年5月31日)	当第3四半期会計期間 (2021年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	30,648	32,916
自己株式	△4,767	△4,769
株主資本合計	63,482	65,748
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	58	98
繰延ヘッジ損益	0	△6
評価・換算差額等合計	58	91
純資産合計	63,541	65,840
負債純資産合計	101,576	90,229

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2020年2月29日)	当第3四半期累計期間 (自 2020年6月1日 至 2021年2月28日)
売上高	68,822	63,678
売上原価	60,780	55,661
売上総利益	8,042	8,017
販売費及び一般管理費	3,244	3,161
営業利益	4,797	4,856
営業外収益		
受取利息	2	1
受取配当金	11	9
固定資産売却益	1	20
その他	23	25
営業外収益合計	39	56
営業外費用		
支払利息	0	0
固定資産除売却損	298	92
その他	9	5
営業外費用合計	308	98
経常利益	4,528	4,813
税引前四半期純利益	4,528	4,813
法人税、住民税及び事業税	1,135	1,221
法人税等調整額	278	295
法人税等合計	1,414	1,517
四半期純利益	3,114	3,296

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報
前第3四半期累計期間(自 2019年6月1日 至 2020年2月29日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	34,366	34,456	—	68,822	—	68,822
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3	200	3,149	3,354	△3,354	—
合計	34,369	34,657	3,149	72,176	△3,354	68,822

当第3四半期累計期間(自 2020年6月1日 至 2021年2月28日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	34,560	29,118	—	63,678	—	63,678
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	301	2,431	2,735	△2,735	—
合計	34,562	29,420	2,431	66,414	△2,735	63,678